Hirata
平田機工株式会社

証券コード：6258 / 2024年8月

決算説明資料

2024年度（2025年3月期）
第1四半期

目 次

Ⅰ. 2024年度　第1四半期業績（連結）

Ⅱ. 2024年度　通期業績予想（連結）

Ⅲ. 参考資料

※2024年度:2025年3月期

会社概要

会 社 名	平田機工株式会社 （英文表記：HIRATA Corporation）
所 在 地	熊本県熊本市北区植木町一木111番地
代表者名	代表取締役社長執行役員　平田 雄一郎
設 立	1951年12月29日
資 本 金	2,633 百万円
事業内容	各種生産システム、産業用ロボットおよび物流関連機器等の製造ならびに販売
上場市場	東京証券取引所 プライム市場（証券コード 6258）
従 業 員	連結 2,439名 単体 1,530名　※2024年6月30日現在
事 業 所	国内7拠点（熊本県4拠点、栃木県、滋賀県、東京都）
関係会社	国内3社（熊本県2社、東京都） 海外9社（アメリカ、メキシコ、ドイツ、シンガポール、タイ、マレーシア、中国2社・台湾）

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

Ⅰ. 2024年度 第1四半期業績（連結）

Hirata

業績概要 ※第1四半期累計

- 受 注 高　対前年同期で減。半導体関連を中心に減少。自動車関連･その他自動省力機器も顧客の投資延期等で対前年同期減
- 売 上 高　対前年同期で増。自動車を中心に受注残案件の生産が進捗
- 営業利益　対前年同期で減。利益率の高い半導体関連の売上減少や人件費増等による販管費の増加が影響

（単位：百万円）

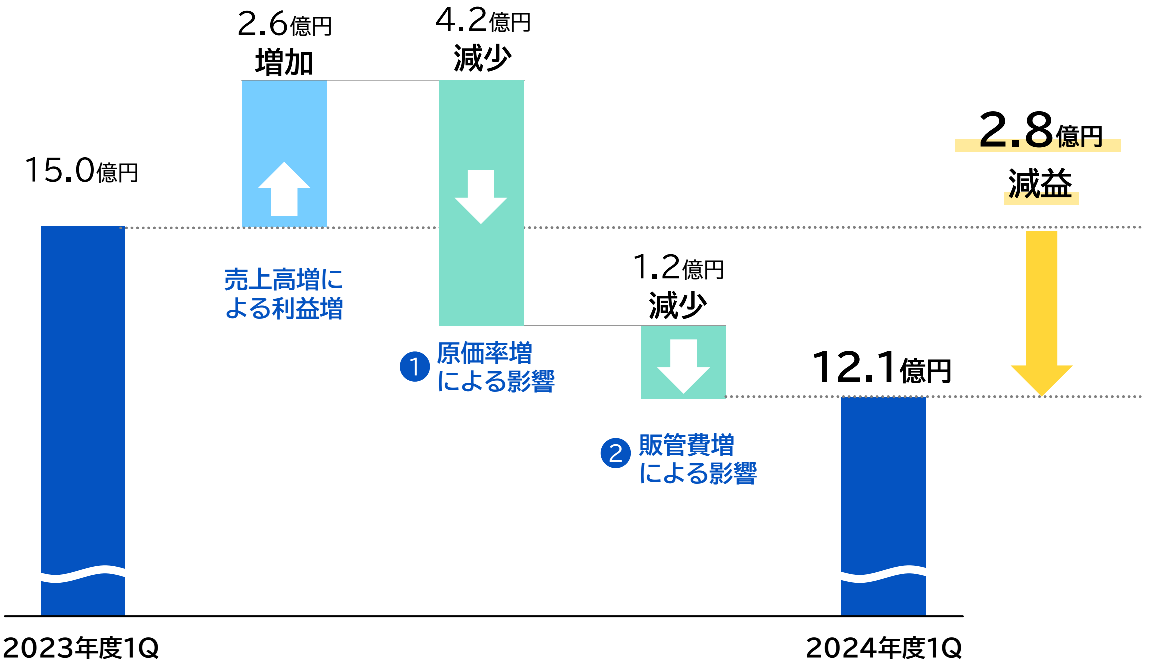
	2023年度1Q	2024年度1Q	対前年同期	
	実 績	実 績	増 減 額	増 減 率
受注高	24,567	19,892	▲4,675	▲19.0%
売上高	19,155	20,368	1,213	6.3%
営業利益（利益率）	1,503（7.9%）	1,214（6.0%）	▲289	▲19.3%
経常利益	1,580	1,279	▲300	▲19.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,105	722	▲383	▲34.6%
受注残高	67,417	64,928	▲2,488	▲3.7%

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

営業利益の増減要因分析

Hirata

- 営業利益は対前年同期で**2.8億円減**
  - **主な増加要因**：売上高の増加
  - **主な減少要因**：一部案件での原価率増や販管費の増加等



① 原価率増による影響

原価率 78.4% ⇒ 80.5%

原価率増の主な要因

- 一部案件の原価率悪化
- 製造にかかる人件費・外注費の増

② 販管費増による影響

販管費増の主な要因

- 賃上げ・人員増による人件費増
- システム関連費用増
- 売上拡大に伴う販管費増

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

セグメント別業績

（単位：百万円）

		2023年度1Q	2024年度1Q	増減	増減率
受注高	合計	24,567	19,892	▲4,675	▲19.0%
	自動車	12,355	12,307	▲48	▲0.4%
	半導体	9,223	4,828	▲4,395	▲47.7%
	その他自動省力機器	2,406	2,176	▲229	▲9.5%
	その他	582	580	▲2	▲0.3%
売上高	合計	19,155	20,368	1,213	6.3%
	自動車	8,079	9,824	1,745	21.6%
	半導体	7,765	7,055	▲710	▲9.2%
	その他自動省力機器	2,811	2,932	120	4.3%
	その他	498	556	58	11.7%
営業利益	合計	1,503	1,214	▲289	▲19.3%
	自動車	498	476	▲22	▲4.5%
	半導体	1,096	920	▲176	▲16.1%
	その他自動省力機器	▲70	▲155	▲85	- %
	その他（消去含む）	▲21	▲26	▲5	- %
受注残高	合計	67,417	64,928	▲2,488	▲3.7%
	自動車	35,919	41,632	5,713	15.9%
	半導体	23,210	17,243	▲5,967	▲25.7%
	その他自動省力機器	7,615	5,540	▲2,075	▲27.3%
	その他	672	512	▲159	▲23.8%

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

Hirata

セグメント別業績 ： 自動車関連

- 受注高は前年同期並み。EV･内燃機関の引合いは堅調。EV向けバッテリー充放電関連設備の大型案件も受注
- 売上高は対前年同期で増。前期受注済のEV関連案件（主にEDUやバッテリー関連等）および内燃機関案件の生産が進捗
- 営業利益は対前年同期で減。一部案件の原価率が悪化したことに加え、販管費の増も影響

（単位：百万円）

		2023年度1Q		2024年度1Q		対前年同期	
		実 績	セグメント内構成比	実 績	セグメント内構成比	増 減 額	増 減 率
受注高		12,355	-	12,307	-	▲48	▲0.4%
	EV	11,315	91.6%	8,828	71.7%	▲2,486	▲22.0%
	その他	1,040	8.4%	3,478	28.3%	2,438	234.3%
売上高		8,079	-	9,824	-	1,745	21.6%
	EV	6,141	76.0%	7,192	73.2%	1,050	17.1%
	その他	1,937	24.0%	2,632	26.8%	694	35.9%
受注残高		35,919	-	41,632	-	5,713	15.9%
営業利益		498	-	476	-	▲22	▲4.5%
営業利益率		6.2%	-	4.8%	-	-	-

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

セグメント別業績 ： 半導体関連

- 受注高は対前年同期で減。ウェーハ搬送以外の受注が大幅増となった前年同期を下回る。ただし、市場は回復基調にあると認識
- 売上高は対前年同期で減。ウェーハ搬送は増加するもその他（検査機関連・PLP関連等）の減が影響
- 営業利益は対前年同期で減。売上が減少したことに加え、製造原価・販管費の増も影響

（単位：百万円）

		2023年度1Q		2024年度1Q		対前年同期	
		実 績	セグメント内構成比	実 績	セグメント内構成比	増 減 額	増 減 率
受注高		9,223	-	4,828	-	▲4,395	▲47.7%
	ウェーハ搬送	5,151	55.9%	4,269	88.4%	▲882	▲17.1%
	その他	4,072	44.1%	558	11.6%	▲3,513	▲86.3%
売上高		7,765	-	7,055	-	▲710	▲9.2%
	ウェーハ搬送	4,588	59.1%	4,970	70.5%	381	8.3%
	その他	3,177	40.9%	2,084	29.5%	▲1,092	▲34.4%
受注残高		23,210	-	17,243	-	▲5,967	▲25.7%
営業利益		1,096	-	920	-	▲176	▲16.1%
営業利益率		14.1%	-	13.0%	-	-	-

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

セグメント別業績 ： その他自動省力機器

- 受注高は対前年同期で減。有機ELの受注に支えられた前年同期を下回る。顧客の設備投資の延期等も影響
- 売上高は対前年同期で増。前期受注済の有機EL案件の生産が進捗
- 営業利益は対前年同期で減。一部案件の原価率が悪化したことに加え、販管費の増も影響

（単位：百万円）

	2023年度1Q		2024年度1Q		対前年同期	
	実 績	セグメント内構成比	実 績	セグメント内構成比	増 減 額	増 減 率
受注高	2,406	-	2,176	-	▲229	▲9.5%
売上高	2,811	-	2,932	-	120	4.3%
受注残高	7,615	-	5,540	-	▲2,075	▲27.3%
営業利益	▲70	-	▲155	-	▲85	-%
営業利益率	▲2.5%	-	▲5.3%	-	-	-

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

Hirata

貸借対照表

（単位 ： 百万円）

資産	2023年度	2024年度1Q	増減
流動資産	88,554	92,376	3,822
現金及び預金	10,652	8,924	▲1,728
売上債権等	59,504	65,093	5,589
棚卸資産	14,264	14,638	374
その他	4,131	3,719	▲412
固定資産	42,233	42,245	12
有形固定資産	27,437	27,229	▲208
無形固定資産	904	1,033	128
投資その他の資産	13,891	13,983	92
資産合計	130,787	134,622	3,834

負債	2023年度	2024年度1Q	増減
流動負債	49,864	48,522	▲1,342
固定負債	15,621	20,823	5,202
負債合計	65,485	69,346	3,860

純資産			
純資産合計	65,302	65,276	▲25

主な増減要因

- 売上債権等 ： 大型案件や長納期案件増により増加
- 流動負債 ： 工場増設費や賞与の支払により未払金･未払費用が減少
- 固定負債 ： 大型案件や長納期案件増により長期借入が増加

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

Hirata

Ⅱ. 2024年度 通期業績予想（連結）

Hirata

通期業績予想

● 売上高 1,000億円、営業利益 75億円の増収増益見通し　※2023年度決算発表時（2024年5月10日）より変更はございません

（単位：百万円）

	2023年度	2024年度	対前期	
	実績	通期予想	増減額	増減率
売上高	82,839	100,000	17,160	20.7%
自動車関連	36,984	50,000	13,015	35.2%
半導体関連	27,390	29,000	1,609	5.9%
その他自動省力機器	16,083	19,000	2,916	18.1%
その他	2,381	2,000	△381	△16.0%
営業利益（率）	6,047（7.3%）	7,500（7.5%）	1,452	24.0%
経常利益（率）	6,259（7.6%）	7,300（7.3%）	1,040	16.6%
親会社株主に帰属する当期純利益（率）	4,344（5.2%）	4,700（4.7%）	355	8.2%

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

Hirata

通期業績予想のポイント（売上高）

● 2024年度期初時点で過去最高水準の受注残高を確保していることに加え、EV･半導体分野で堅調な受注が継続する見込みであり、対前期で増収見通し　※2023年度決算発表時（2024年5月10日）より変更はございません

（単位：百万円）

	2023年度	2024年度	対前期	
	実 績	通 期 予 想	増 減 額	増 減 率
売上高	82,839	100,000	17,160	20.7%

<セグメントごとの見通し>

自動車関連

- 北米におけるEV市場の成長鈍化が見られるが、EV、内燃系、ハイブリッドのいずれも対応できる強みを活かして需要を確実に取り込む
- EV向けバッテリー充放電関連設備は2024年度より専門部署を設け、お客様の製品開発段階から参画する等の取組みで受注拡大を見込む

半導体関連

- 生成AI向けの後工程製造装置や車載用パワー半導体への投資活発化による需要拡大を確実に取り込む
- 生産能力の拡大に向けて、既存の中国･台湾に加え、東南アジアにおいて現地子会社との生産協力体制の構築を進める

その他自動省力機器

- 有機ELパネルの大型化に伴い、心臓部の生産に特化
- 家電メーカー向け組立設備案件は、お客様にて開発継続中。受注遅延影響の挽回を図る

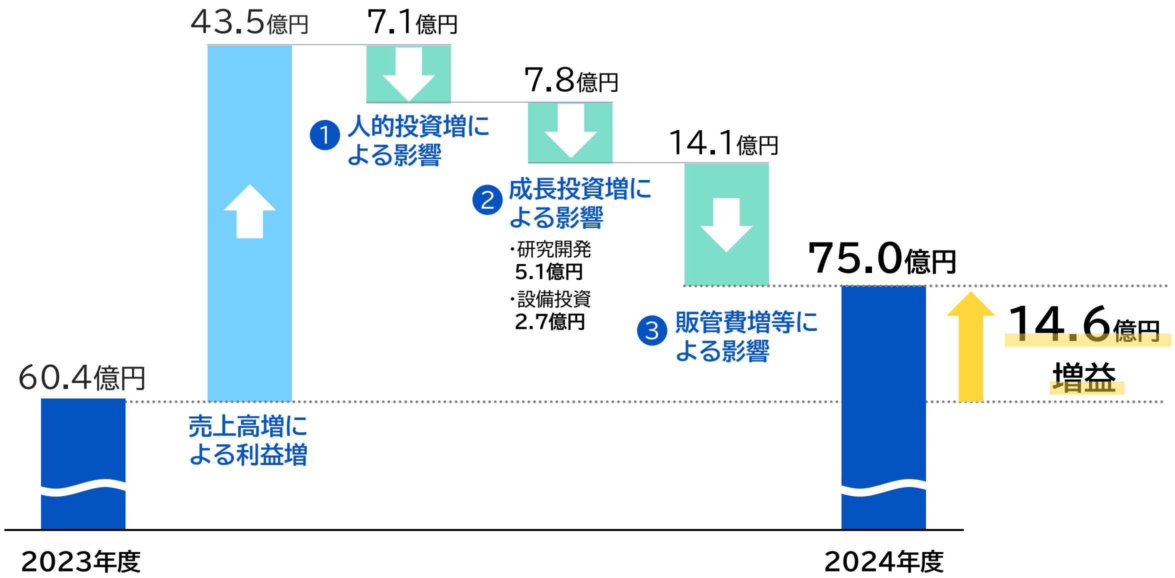
Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

Hirata

通期業績予想のポイント（営業利益）

- 次の成長に向けた「収益性強化」「経営基盤強化」を実現するために人的投資や成長投資を積極的に実施
- 営業利益は対前期で増益となる見通し　※2023年度決算発表時（2024年5月10日）より変更はございません

主な対前期増減要因



① 人的投資 7.1億円

- 将来の事業拡大を見据えた採用増
- 物価高騰への対応、安定的な人材獲得を目的とした賃金増　等

② 成長投資 7.8億円

- 既存事業における次世代製品開発の加速
- 生産性向上に向けた設備投資　等

③ 販管費等 14.1億円

- 売上拡大に伴う販管費等の増
- （原価）調達コストの増　等

※影響額：対前年増減額（2023年度通期実績と比較した2024年度通期の増減予想額）

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

Hirata

1株当たり配当金・配当性向　推移および予想

（単位：円）

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度 予想
1株当たり配当金	40.00	65.00	65.00	90.00	100.00	120.00
配当性向（%）	23.8	16.6	25.2	21.9	23.9	26.5

※配当性向は連結ベースです。

<配当に対する考え方>

当社は、株主に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、財務体質の強化を図りつつ、連結業績や今後の事業展開などを勘案しながら、連結配当性向20%以上を概ねの目安とし、安定的・継続的に行うよう努めております。

今期の配当につきましては、期末配当として120円を予想しております。

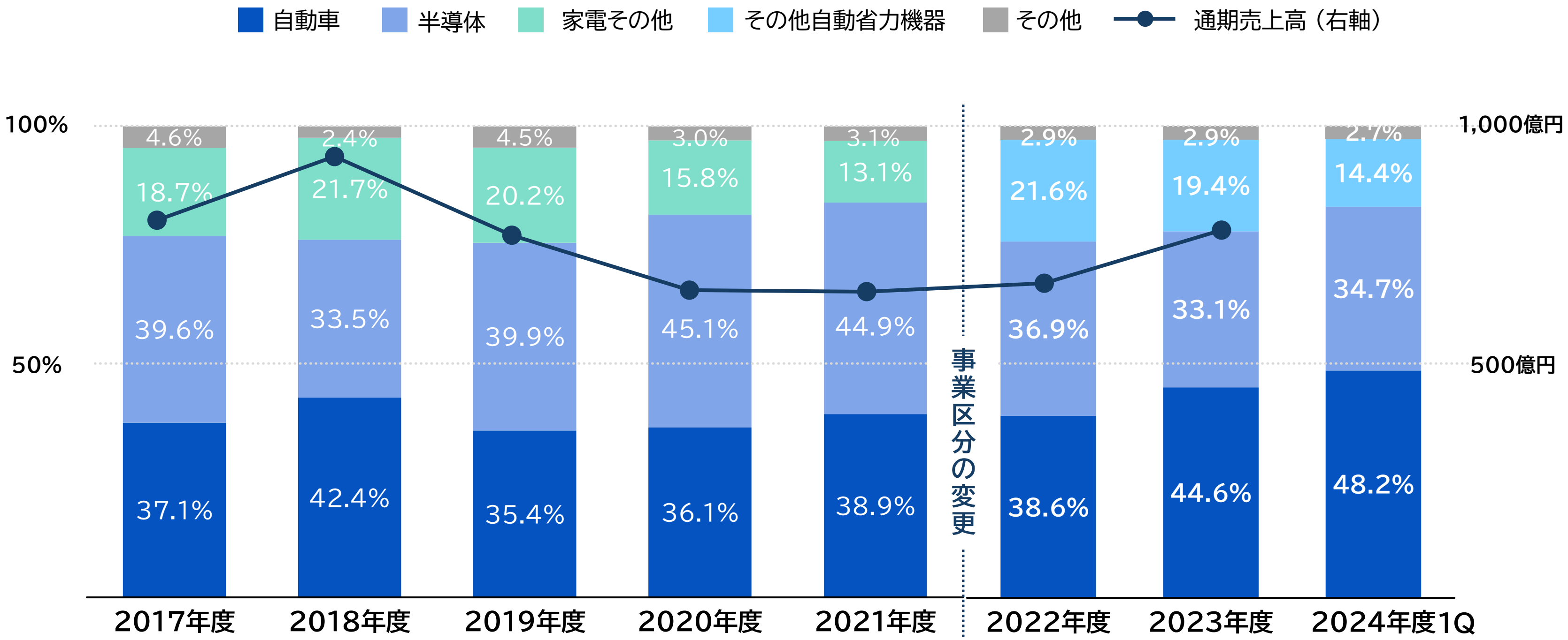
なお、今後の配当に対する考え方につきましては、株主還元策も含めた資本政策の中で検討を進めてまいります。

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

Ⅲ．参考資料

セグメント別 売上高・構成比推移

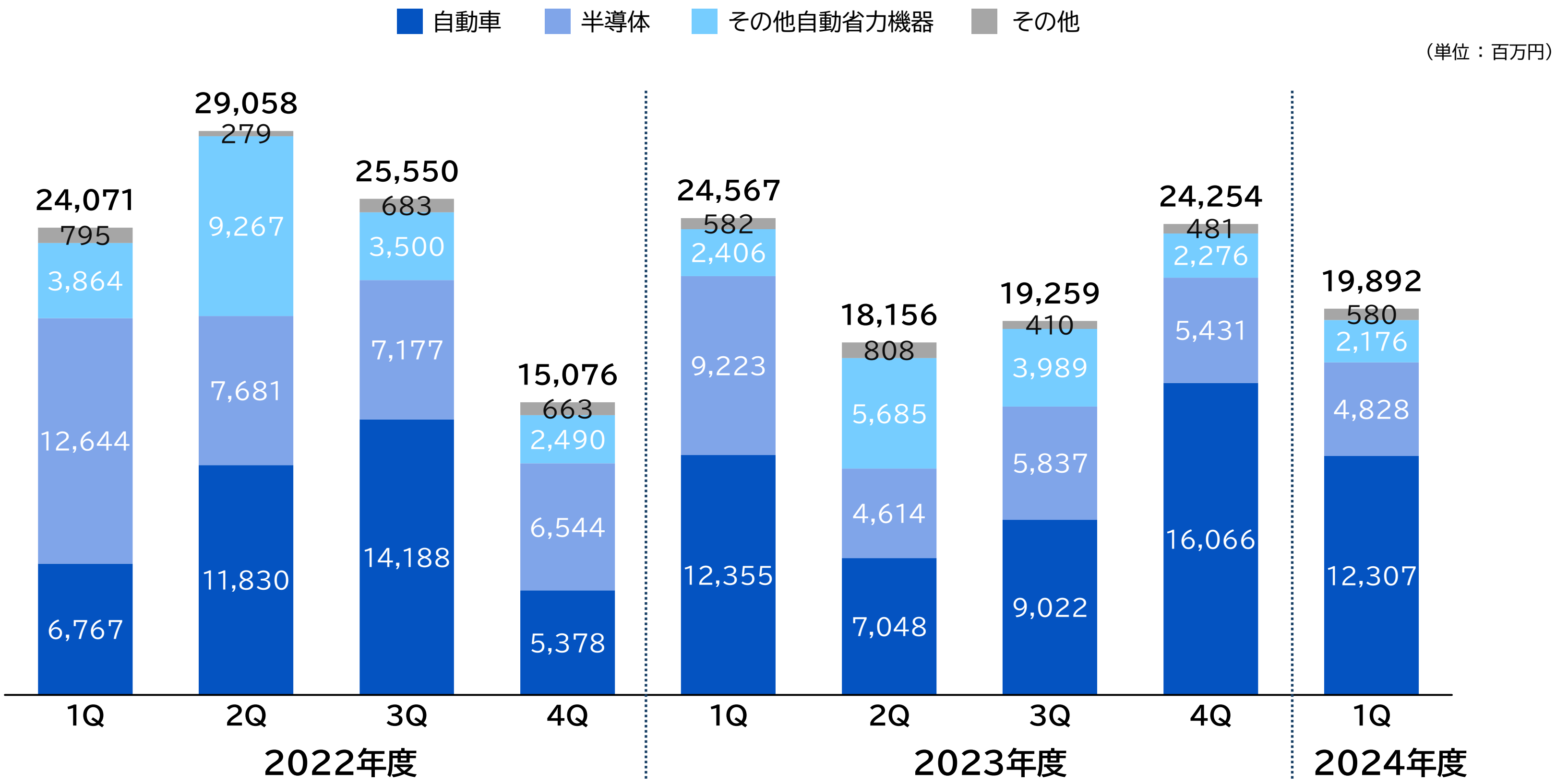
Hirata



※2022年度より、事業区分の変更を行っております。

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

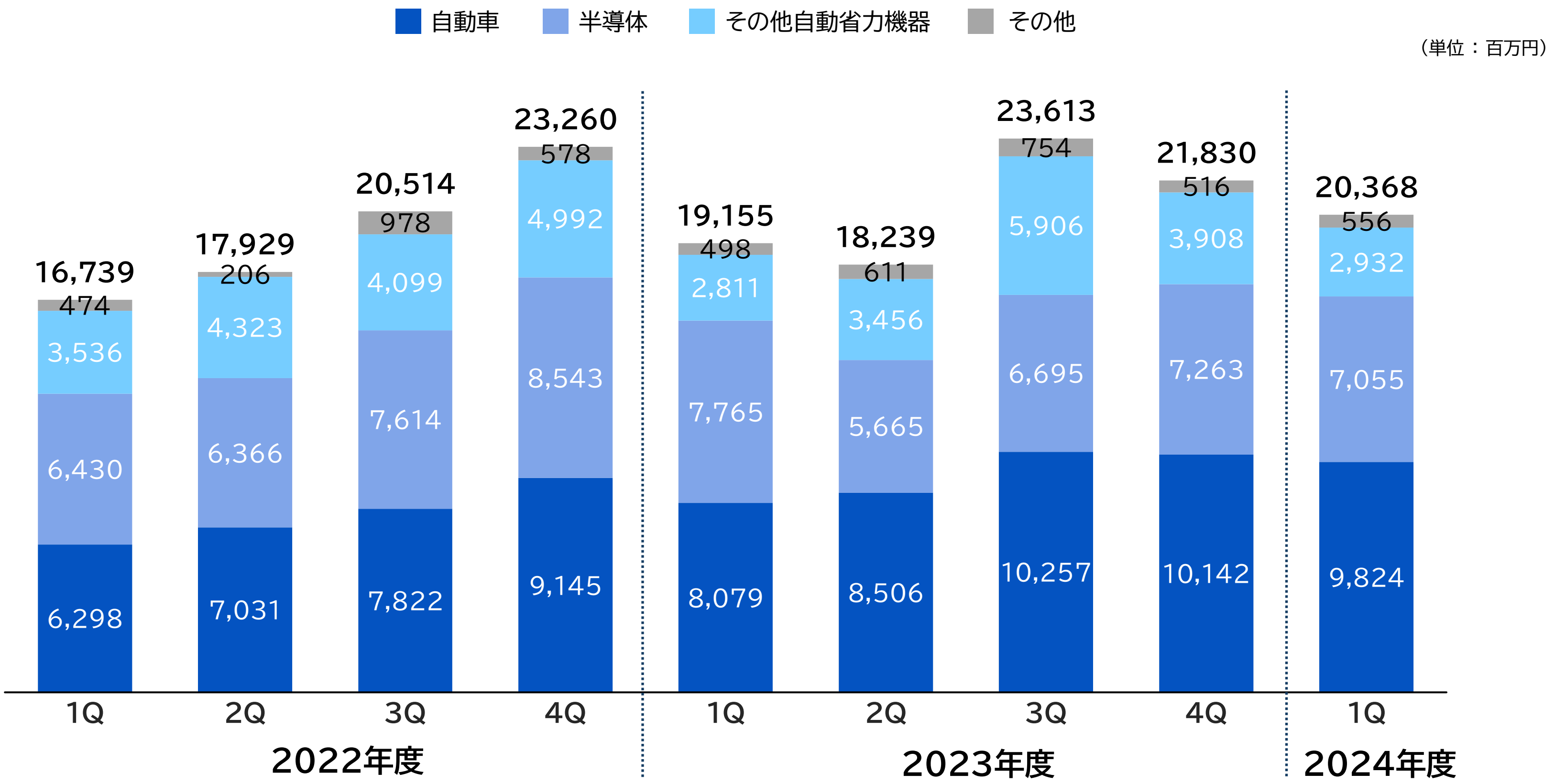
セグメント別 四半期推移【受注高】



Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

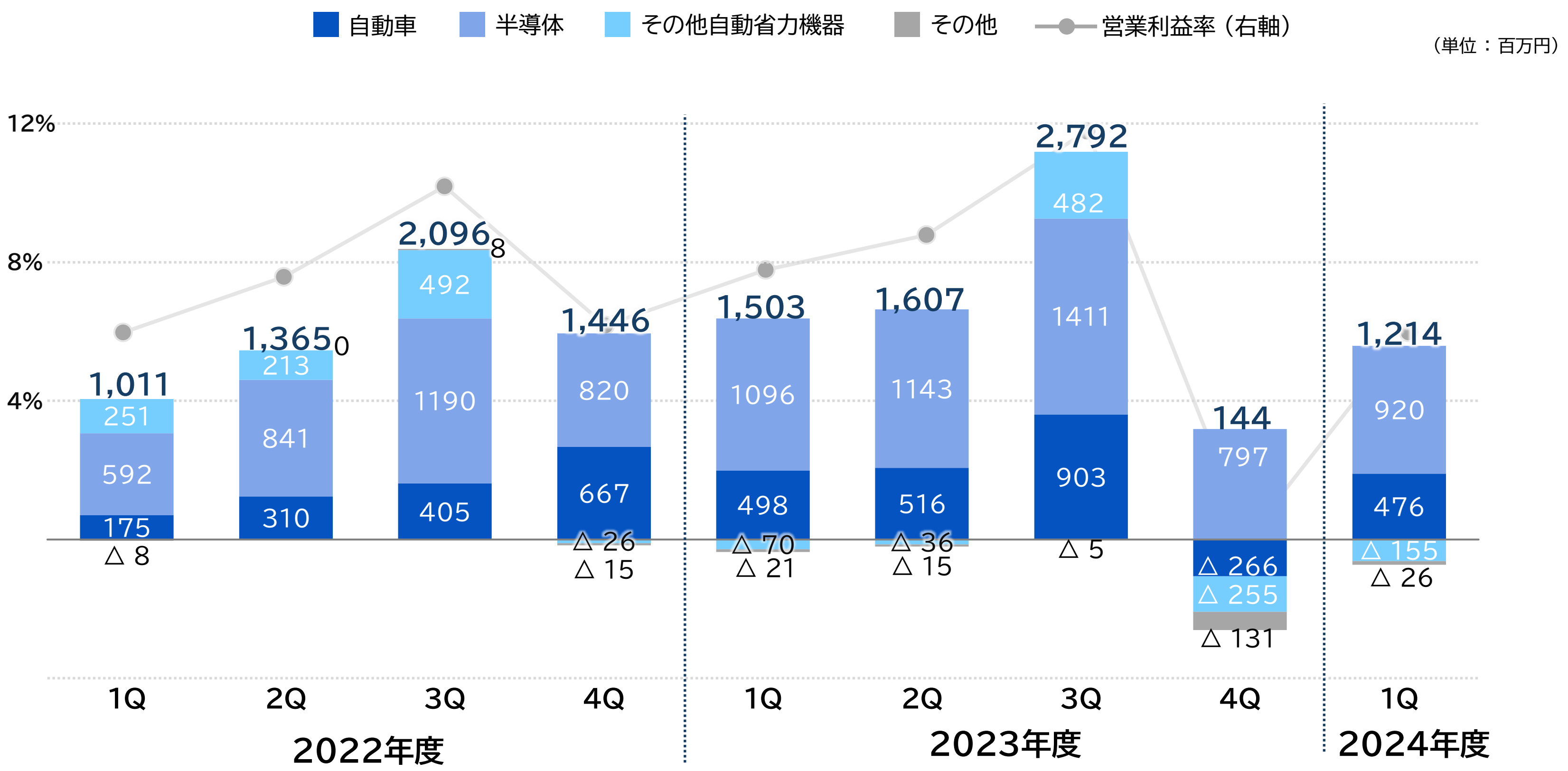
セグメント別 四半期推移【売上高】

Hirata



Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

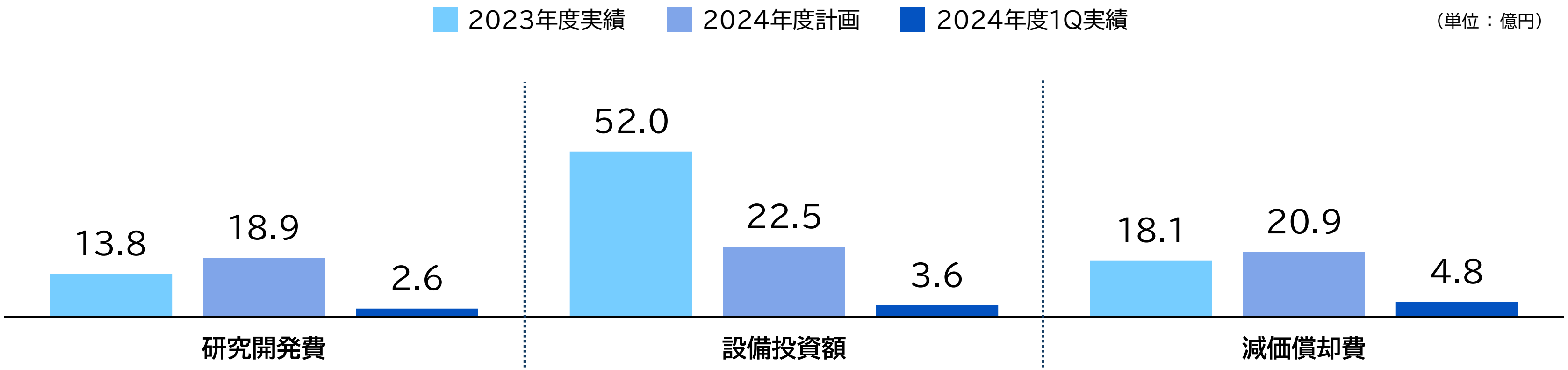
セグメント別 四半期推移【営業利益】 ※その他に消去含む



Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

Hirata

研究開発費・設備投資額・減価償却費



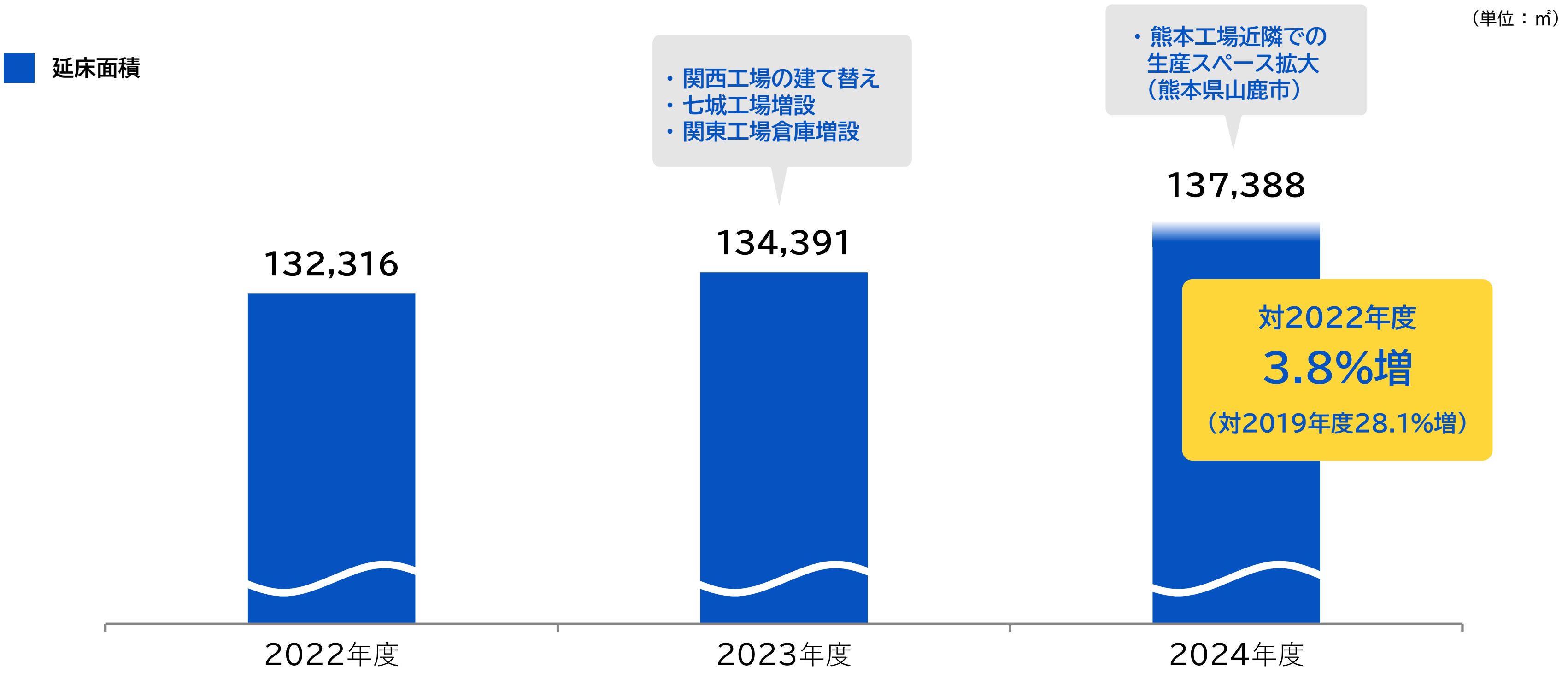
	主な投資内容	2023年度実績	2024年度計画	増減理由
研究開発費	既存事業における次世代製品開発	約 9.2	約 12.3	量産製品の開発を推進
	植物遺伝資源事業関連	約 4.5	約 6.6	減価償却費・人件費の増加
設備投資	工場の建替・増築	約 22.6	約 3.6	大規模な建替・増築は前年度までで一服
	植物遺伝資源事業関連	約 15.3	約 0.1	主要機材の導入が前年度で完了
	情報システム関連	約 2.1	約 1.8	次期基幹システム導入（前年度から継続）
	その他	約 12.0	約 17.1	生産性向上のための小口投資等の集積

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

生産スペース（単体・期末時点）

Hirata

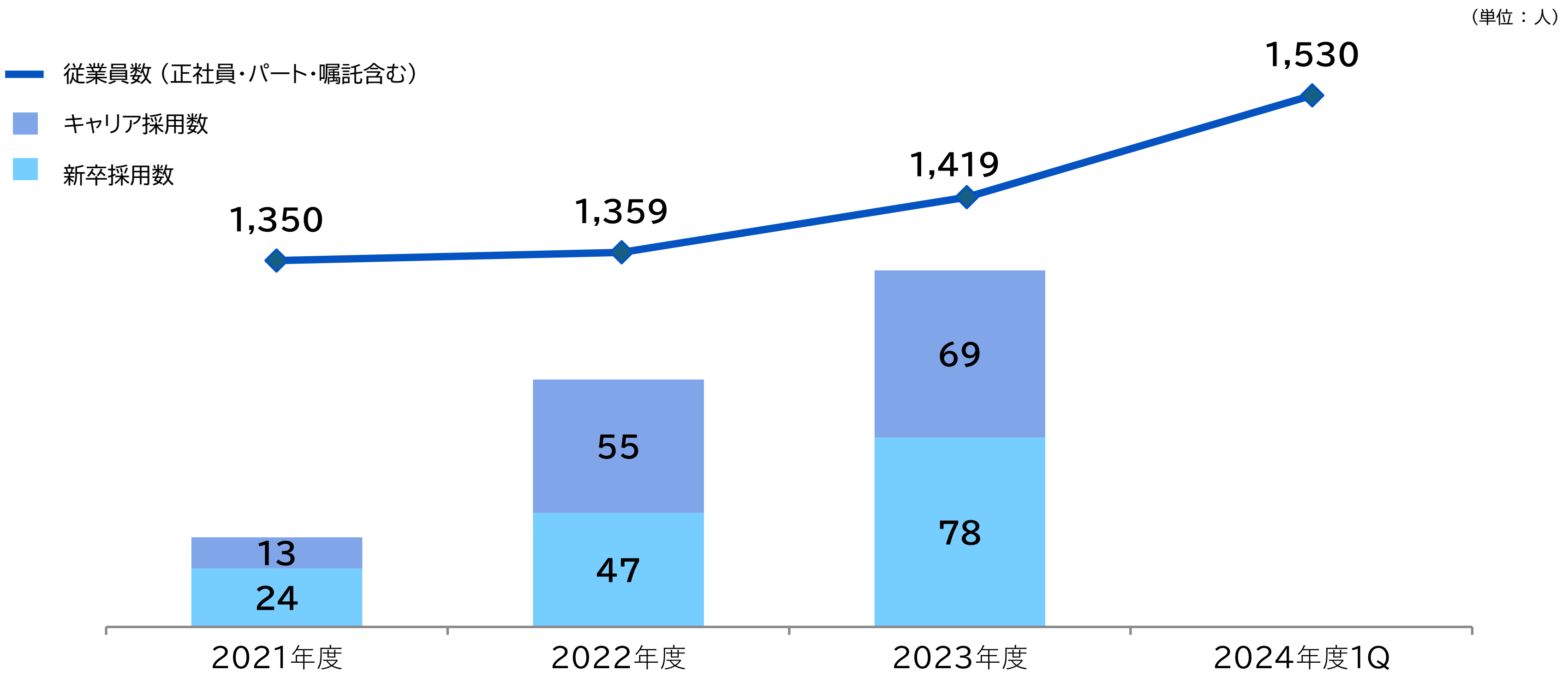
- 生産能力向上に向けた生産スペースの継続的な拡大に取り組んでいる
- 2024年度も熊本市に隣接する山鹿市に生産スペースを確保



Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

採用数・従業員数（単体・期末時点）

- 事業拡大を見据え、継続的な人材確保を図る
- 賃金改善、働き方改革、福利厚生、教育訓練の充実等で人材のリテンションに取り組む



Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

Hirata

想定される主な外部環境起因の機会／リスクと対応策

想定される主な外部環境	想定する機会／リスク	主な対応策
各国の脱炭素・カーボンニュートラルへの取り組み強化	機会 EV・半導体関連の需要増 リスク ● GHG排出量削減に向けた対応（コスト増） ● 生産能力・人的リソース不足による受注取りこぼし	● 既存顧客からの継続的な引合い獲得に向けたQCD向上 ● EV・半導体を成長分野と位置づけリソース集中＝受注拡大を見据えた人材・生産能力への先行投資（人員増、関西工場建替・七城工場増築など） ● GHG排出量削減目標の設定と最適な目標達成施策の検討
米国政権交代による環境関連投資の鈍化	リスク EV市場縮小による顧客の設備投資減	● 顧客との緊密な情報交換による設備投資動向の把握 ● 対応領域拡大による新規顧客・案件確保 ● 主力事業の分散とリソース配分の適正化
新タイプバッテリーの量産化	機会 新技術追従と量産対応による商機拡大 リスク 開発要素負担による収益性悪化	● 顧客の研究開発段階から参画し、顧客要求に即した製品の開発・提案 ● 外部調達による開発費削減
生成AIの普及	機会 半導体関連の需要増 リスク 生産能力・人的リソース不足による受注機会の損失	● 既存顧客からの継続的な引合い獲得に向けたQCD向上 ● 半導体分野へのリソース投入＝受注拡大を見据えた人材・生産能力への先行投資
熊本・九州への半導体関連産業の集積	機会 半導体関連の需要増 リスク 人材獲得競争による人的リソース不足	● 既存顧客からの継続的な引合い獲得に向けたQCD向上 ● 半導体分野へのリソース投入＝受注拡大を見据えた人材・生産能力への先行投資 ● 積極的な人材採用 ● 社会動向も踏まえた賃金改定やリテンションの実施

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

想定される主な外部環境起因の機会／リスクと対応策

想定される主な外部環境	想定する機会／リスク		主な対応策
中東情勢の緊迫化	リスク	原油価格の上昇、輸送コスト・調達コスト増	● 輸送コスト・調達コスト上昇分の見積り反映や価格改定 ● 新規調達先の開拓 ● 標準化による必要部材点数削減
社会的要請に基づく人件費上昇	リスク	● 利益率悪化 ● 販売価格アップによる競争力低下	● 人件費上昇分の見積もり反映や価格転嫁 ● 価格以外の競争優位性確立
原材料費・部材価格の高騰・高止まり	リスク	● 利益率悪化 ● 販売価格アップによる競争力低下	● 調達価格上昇分の見積もり反映や価格転嫁 ● 高付加価値製品の開発・上市 ● 新規調達先の開拓 ● 標準化による必要部材点数削減
調達部材不足	リスク	生産スケジュールの遅延や生産リードタイムの長期化による売上減や原価率悪化、棚卸資産増	● 先行手配による部品在庫確保 ● 新規調達先の開拓 ● 標準化による必要部材点数削減
物流「2024年問題」	リスク	● 輸送運賃上昇による調達コスト増 ● 調達・出荷にかかるリードタイム長期化	● 調達価格上昇分の見積もり反映や価格転嫁 ● 標準化による必要部材点数削減 ● リードタイム長期化を予測した物流手配
為替（急激な円高の進展）	機会 リスク	● 海外調達品（原材料・部材）の価格低下 ● 海外競合との相対的な価格競争力減	● 付加価値向上による競争優位性の確保 ● 海外での現地生産の推進

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

Hirata

トピックス ： 大型案件の受注

2023年度以降に開示した大型受注案件

事業部門	開示日		設備概要	金額
自動車関連	2023年	6月	EV用EDU組立設備	**80億円超**
	2024年	1月	EV向けバッテリー充放電関連設備	**40億円超**
		2月	内燃機関向けエンジン組立設備	**約130億円**
		5月	EV向けバッテリー充放電関連設備	**約25億円**

EV向けバッテリー充放電関連設備の受注実績

2022年度以降の累計受注額は**90億円超（7ライン）**

- バッテリー充放電関連設備は2022年度より本格的な受注を開始（2023年12月までの受注は2ラインで約25億円）
- 大規模案件への対応力ならびにEV向けバッテリー充放電関連設備の納入実績等が評価され、継続して受注獲得

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

Hirata

ESG経営の取り組み強化

2022年	10月	「人権方針」策定、「調達基本方針」改定
2023年	4月	サステナビリティ推進委員会発足 HPに「サステナビリティページ」を新設し、ESGの情報発信を強化
	9月	「国連グローバル・コンパクト」署名
	10月	人権デュー・ディリジェンス導入
	11月	経団連「企業行動憲章」への賛同表明
2024年	1月	「Hirataグループ行動規範」制定 サステナビリティ推進委員会に「人権尊重ワーキンググループ」設置
	6月	「FTSE Blossom Japan Index」 「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定

WE SUPPORT
UN GLOBAL COMPACT

FTSE Blossom Japan Index

FTSE Blossom Japan Sector Relative Index

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

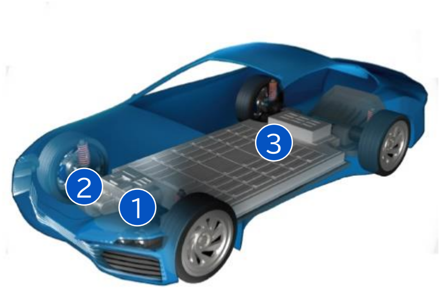
Hirata

事業概要 ： 自動車関連の主要製品

● EV関連を中心に、北米自動車メーカー（ビッグスリー）・北米新興EVメーカー・国内電子部品メーカーから継続受注

EV関連の主力・拡大分野

当社が手掛ける生産設備



※完成製品イメージ

① EDU組立設備 主力分野

EDU（Electric Drive Unit）と呼ばれる車載用のモーターとギアボックスを組み合わせた、EVの駆動用部品の組立設備を製造

② IGBT・インバーター組立設備 主力分野

IGBTやインバーターといった、EVやトランスミッション車に搭載される車載用電子部品の組立設備を製造

③ バッテリー関連組立設備（セル充放電工程） 拡大分野

バッテリーのセル工程の一部である充放電工程の搬送設備を製造

主要な地域・顧客・優位性

EDU組立設備

北米

顧客
- 北米自動車メーカー（ビッグスリー）
- 北米新興EVメーカー

IGBT・インバーター組立設備

日本

顧客 国内車載用電子部品メーカー

バッテリー関連組立設備（充放電工程）

日本

顧客 国内バッテリーメーカー

当社の競争優位性

- 最長で総延長1kmを超える大型設備を自社のみで手掛ける技術力
- 顧客の生産ラインを一度自社工場内で構築し、生産能力・品質を検証した上で現地据え付け
- 開発から生産・保守までの一貫体制
- 顧客要求に応えるエンジニアリング力

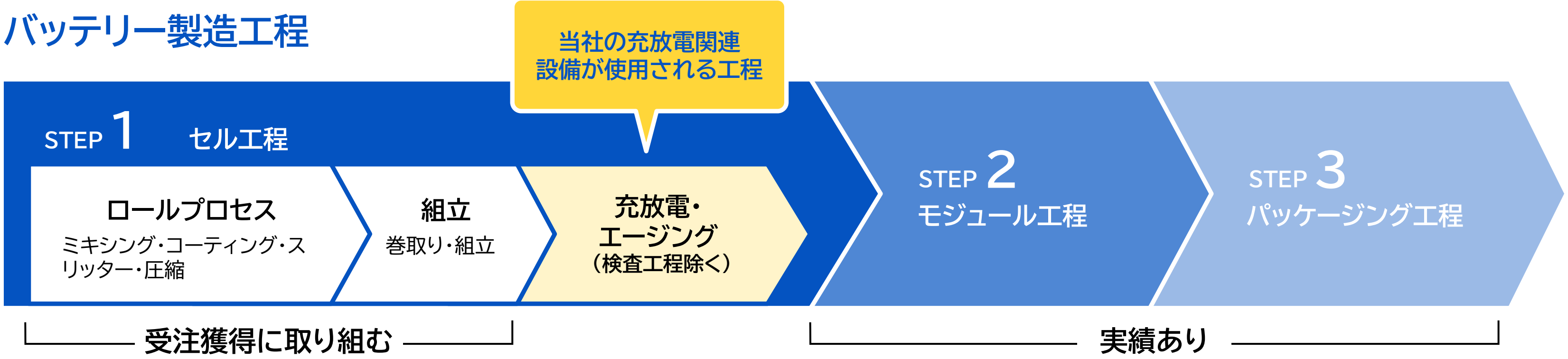
Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

禁転載

事業概要 ： 充放電関連設備

- セル製造の最終工程である「充放電・エージング」を担う充放電関連設備
- 搬送・ストッカー技術を生かしたシステム化に当社優位性あり

バッテリー製造工程



当社の製品：充放電関連設備

- 組み立てられたセル（電池）に充放電を繰り返すことでセルを活性化させる（バッテリーとしての機能をもたせる）工程
- 当社で製造した搬送ラインや自動倉庫に、外部より調達した充放電機を組み込み、システムとしてお客さまに納品。
  当社の搬送・ストッカー技術が差別化要因

搬送システム	工程間の最適搬送を行う
エージング用倉庫システム	高温環境でのテストや自動倉庫に長期間収納放置し、一定期間後のセル電圧をパフォーマンス測定
充放電用倉庫システム	満充電と放電を数回繰り返す工程。充電容量、充電速度、繰り返し回数等によって数時間を要する

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.
禁転載

Hirata

事業概要 ： 半導体関連の主要製品

● 国内製造装置メーカー向けのウェーハ搬送装置や検査装置間のハンドリング装置を中心に継続受注

半導体関連の主力・拡大分野

主力分野

ウェーハ搬送装置 EFEM ロードポート 搬送ロボット

シリコンウェーハを各種処理装置に取り込む**ロードポート**、大気・真空環境に対応可能な**ウェーハ搬送ロボット**およびそれらを統合した**EFEM**を製造

主力分野

検査装置間の搬送装置

完成したICチップを検査装置や別のトレイに運搬・移載する**ハンドリング装置**などを製造

拡大分野

PLP

PLP工程等に使用される、パネル基板搬送用の**EFEM・ロードポート・ウェーハ搬送ロボット**やパネル製造用の**搬送設備**を製造

主要な地域・顧客・優位性

ウェーハ搬送装置

日本

顧客 国内製造装置メーカー

検査装置間の搬送装置

北米・日本

顧客
- 北米デバイスメーカー
- 国内検査装置メーカー

PLP

北米・欧州・日本

顧客
- 北米デバイスメーカー
- 国内/欧州基板製造メーカー

当社の競争優位性

- 豊富なコンポーネントのラインナップ
- 顧客の要望に合わせたカスタマイズ・最適化に必要な知見・技術
- 開発から生産・保守までの一貫体制
- 顧客要求に応えるエンジニアリング力

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

禁転載

Hirata

事業概要 ： ウェーハ搬送装置

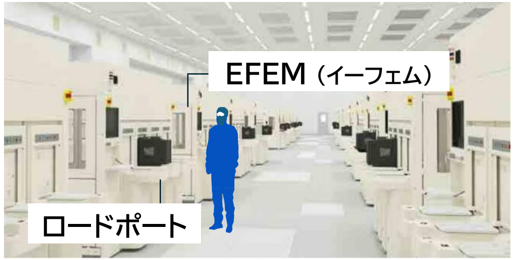
● 主に半導体製造の前工程でウェーハを各種処理装置に取り込む**ロードポート**、ウェーハの受け渡しを行う**ウェーハ搬送ロボット**およびそれらを統合した**EFEM**を設計・製造

半導体製造工程

当社ウェーハ搬送装置が主に使用される工程 → 前工程

設計	前工程	後工程
• 回路・パターン設計 • フォトマスク作成	• ウェーハの作成 • **回路パターン作成** 　• **ウェーハ表面の酸化** 　• **薄膜形成** 　• **フォトマスクのパターン転写** 　• **イオン注入**	• ダイシング • ダイボンディング • ワイヤーボンディング • パッケージング • 製品化と最終検査

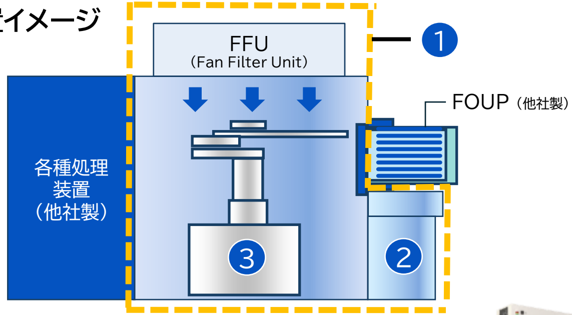
当社製品設置イメージ



処理装置ごとにEFEM・ロードポートが設置されるため1つのラインで複数のEFEM・ロードポートが用いられる

当社の主要製品

当社製品設置イメージ



① **EFEM**（Equipment Front End Module）
処理装置ごとに置かれ、内部にウェーハ搬送ロボット、前面にロードポートが設置される。

② **ロードポート**
FOUP※の裏面の蓋の開閉を行う。EFEMを構成する装置であるが、単品での販売も行っている

③ **ウェーハ搬送ロボット**
FOUPからウェーハを取り出し、処理装置へ搬送。処理後、再びFOUPに収納する。EFEMを構成する装置であるが、単品での販売も行っている。

※FOUP：複数枚のウェーハを収納し工程間を移動するウェーハの容器

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

禁転載

事業概要 ： PLP

Hirata

● 先端パッケージング技術として拡大が期待される「PLP」で用いられる搬送装置を設計・製造

半導体製造工程

当社の装置が主に使用される工程

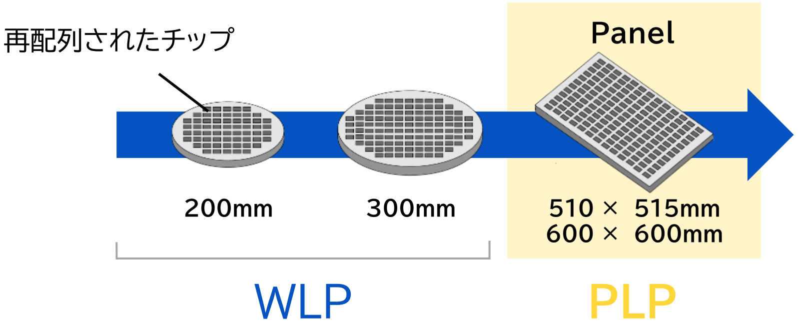
設計	前工程	後工程
• 回路・パターン設計 • フォトマスク作成	• ウェーハの作成 • 回路パターン作成 　• ウェーハ表面の酸化 　• 薄膜形成 　• フォトマスクのパターン転写 　• イオン注入	• ダイシング • ダイボンディング • ワイヤーボンディング • **パッケージング** • 製品化と最終検査

PLP (Panel Level Packaging) とは

- パッケージング工程で、回路形成後に個々に切り分けた多数のチップを、薄型で四角形のパネル基板に再配列し、一括成形するパッケージング技術
- PLPでは一般的に510×515mm角など、ウェーハの標準規格である300mmより大きいパネル基板が用いられる
- パネル基板には、プリント基板や液晶パネル製造用のガラス基板・銅板を使用

パッケージング工程の違い

従来のパッケージ	ウェーハ上に回路を形成し、チップを細かく切り分けたのち、個々に基板に接着・封止して製品化
WLP (Wafer Level Package)	チップを個々に切り分けた後、**良品チップのみをウェーハに再配列**し、チップがウェーハ上にある状態で基板に接着・封止し、個々に切り分ける
PLP (Panel Level Package)	チップを個々に切り分けた後、**良品チップのみを四角形のパネルに再配列**し、チップが**パネル上にある状態**で基板に接着・封止し、個々に切り分ける



Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

禁転載

事業概要 ： その他自動省力機器

Hirata

● 有機ELの蒸着装置や家電メーカー向けの組立設備、医療理化学機器などさまざまな産業分野向け製品を製造

その他自動省力機器の主力・新規分野

主力分野

医療理化学機器

検体検査用の装置（病理組織標本作製装置や全自動連続薄切装置）を製造

主力分野

家電メーカー向け組立設備

高性能家電に組み込まれるモーターの組立設備をはじめあらゆる設備・装置を製造

有機EL用蒸着装置

有機ELパネル用の真空蒸着装置の製造を受託

収益化に向けた新規分野

超音波ガイド下 集束超音波治療装置

- すい臓がんを対象にした集束超音波治療装置をソニア・セラピューティクス社（本社：東京都新宿区、以下ソニア社）と共同開発中
- ソニア社の集束超音波技術と当社ロボット技術を融合させ、患者にやさしい非侵襲的ながん治療を目指す
- 人での臨床試験がスタートし、次なる量産用装置の開発に着手した

主要な地域・顧客・優位性

医療・理化学機器

日本

顧客　国内医療専門メーカー

家電メーカー向け組立設備

アジア

顧客　アジア家電製造メーカー

有機EL用蒸着装置

日本

顧客　国内製造装置メーカー

当社の競争優位性

- さまざまな分野の生産設備・装置に携わってきた豊富な知見とノウハウ
- 開発から生産・保守までの一貫体制
- 顧客要求に応えるエンジニアリング力

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

禁転載

本資料のお取扱い上のご注意

ご注意

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化などのさまざまな要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.